

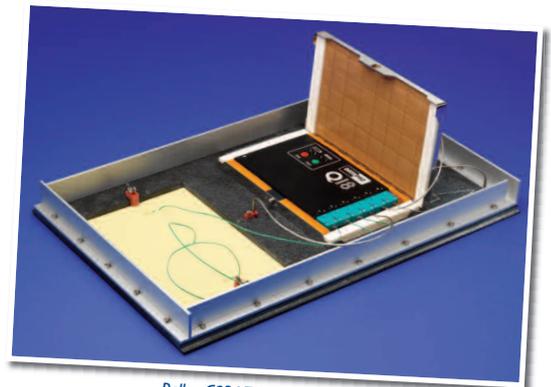
## KIT DI ANALISI SALDATURA A ONDA

per l'uso con il sistema Datapaq Reflow Tracker

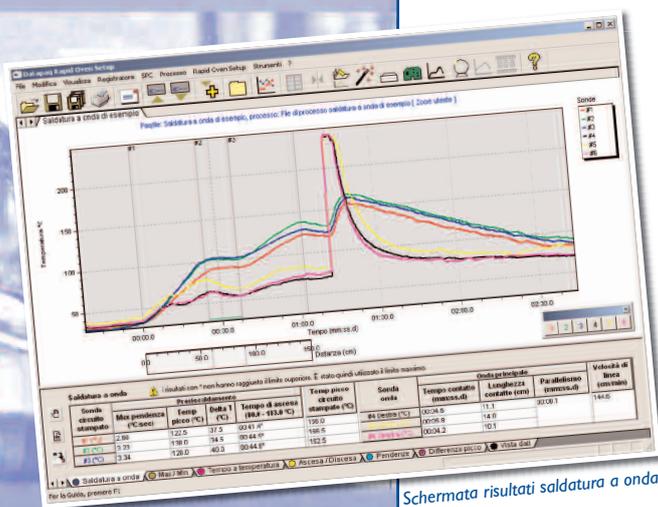
**Il software Insight per Reflow Tracker supporta ora le funzioni di analisi specifiche necessarie per il monitoraggio della saldatura a onda. Il kit di analisi saldatura a onda consente di adattare un sistema Reflow Tracker, normalmente utilizzato per i profili di temperatura nei forni di rifusione, al monitoraggio dei processi di saldatura a onda. Si può quindi utilizzare il software Insight per analizzare i dati di entrambi i tipi di processo, garantendo la compatibilità dei dati in tutta la fabbrica e riducendo al minimo la necessità di formazione degli operatori.**

Tutti i parametri critici del processo di saldatura a onda possono essere visualizzati in una tabella di lettura intuitiva. Sono visualizzati tutti i dati relativi all'onda, all'onda chip (se presente) e al preriscaldamento, insieme al grafico di profilo della temperatura.

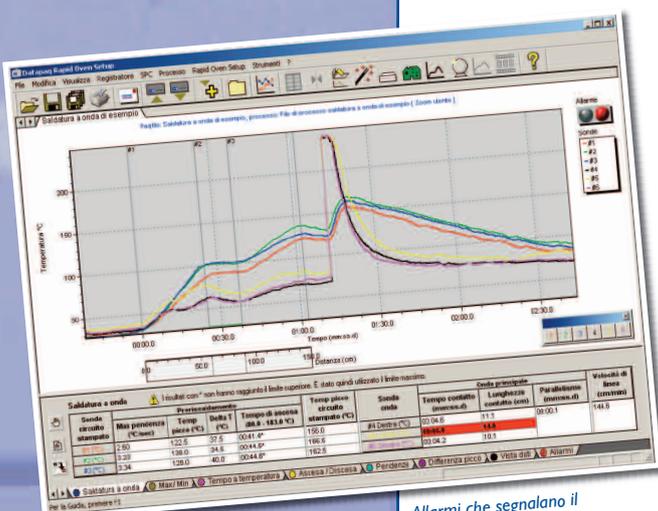
Il sistema utilizza un pallet per trasportare il registratore dati e la barriera termica attraverso il processo. Il pallet incorpora termocoppie fisse, garantendo precisione e ripetibilità senza i costi di acquisto di un analizzatore dedicato.



Pallet CS3070 con registratore



Schermata risultati saldatura a onda



Allarmi che segnalano il superamento, in un processo, dei limiti di tolleranza

### FUNZIONI DEL SOFTWARE INSIGHT PER LA SALDATURA A ONDA:

Il kit di analisi saldatura a onda di Datapaq consente di eseguire un profilo delle temperature effettive del circuito stampato o del componente. In alternativa, è possibile monitorare la stabilità del processo utilizzando il pallet con il provino di circuito stampato integrato. Sono mostrati chiaramente i risultati per le aree di preriscaldamento e saldatura a onda del processo.

L'analisi del preriscaldamento comprende:

- Pendenze massime
- Tempi di ascesa
- Temperatura massima nella zona di preriscaldamento
- Delta T dell'onda
- Temperatura massima lungo l'onda

L'analisi dell'onda comprende:

- Tempo di contatto (sinistra e destra)
- Lunghezza contatto (sinistra e destra)
- Parallelismo
- Velocità di linea

### PROCEDURE GUIDATE

Le procedure guidate conducono l'utente passo passo attraverso un particolare processo, dando a ogni passaggio la possibilità di tornare indietro se ci si rende conto di aver commesso un errore.

### ALLARMI IN CASO DI PROFILO ESTERNO AI LIMITI DI TOLLERANZA

Il software può essere configurato in modo che, qualora i risultati siano esterni ai limiti nelle aree di saldatura a onda o preriscaldamento, venga visualizzato un allarme.

Datapaq ha deciso di offrirvi la massima flessibilità nella scelta del metodo di monitoraggio del processo di saldatura a onda:

- *Pallet per saldatura a onda Datapaq con provino di circuito stampato integrato, per il monitoraggio regolare e ripetibile dei processi.*
- *Pallet per saldatura a onda Datapaq con le termocoppie restanti fissate al prodotto del cliente, per il monitoraggio della stabilità dell'onda e delle temperature effettive del circuito stampato o del componente durante il processo.*



Scelta tra pannello di vetro di controllo o provino di circuito stampato

Il software di analisi Insight consente di monitorare sia il processo di saldatura a rifusione, sia quello di saldatura a onda. In tal modo si riduce la necessità di istruire gli operatori nell'uso di più sistemi e si garantisce l'uniformità dei dati in tutta l'area di produzione. Il software è totalmente compatibile con l'utilizzo in rete, consentendo l'accesso ai dati di profilo a tutti gli utenti della stessa sede.

## CODICI PARTI

### **CS3070 Pallet per saldatura a onda con 3 termocoppie e provino di circuito stampato**

Consente il monitoraggio affidabile e ripetibile dei processi di preriscaldamento e saldatura a onda.

Consiste nel pallet con termocoppie PA1320 e PA1320 e provino di circuito stampato CS3072.

Dimensioni: 40 mm (H) x 300 mm (L) x 350 mm (P)

È anche possibile montare il pannello di vetro di controllo CS3071.

### **CS3071 Pannello di vetro di controllo**

Da utilizzare con l'articolo CS3070.

Consente un rapido controllo visivo di contatto, lunghezza e uniformità dell'onda.

Dimensioni: 198 mm x 130 mm

### **CS3072 Provino di circuito stampato**

Consente al sistema Datapaq di misurare le temperature di preriscaldamento superiore e inferiore nel processo di saldatura a onda.

### **PA1320/I Termocoppie per saldatura a onda**

Termocoppia da utilizzare in posizione centrale sul pallet per saldatura a onda CS3070.

### **SW5060 Software Reflow Tracker Insight**

Il kit di analisi saldatura a onda è progettato per l'utilizzo con il software Reflow Tracker Insight. È compatibile con l'intera gamma di registratori dati Q18, ad eccezione del modello DQ1861. Datapaq fornisce un'ampia gamma di registratori dati e barriere termiche, adatti a quasi tutte le applicazioni di rifusione e di saldatura a onda. Contattateci per ulteriori informazioni.



**Europa e Asia**  
DATAPAQ Limited,  
Deanland House, 160 Cowley Road,  
Cambridge CB4 0GU, Regno Unito  
Tel: +44 (0)1223 423 141  
Fax: +44 (0)1223 423 306  
e-mail: sales@datapaq.co.uk  
Web: www.datapaq.com

**America del nord e del sud**  
DATAPAQ Inc.  
187 Ballardvale Street  
Wilmington, MA 01887, USA  
Tel: +1 978 988 9000  
Fax: +1 978 988 0666  
e-mail: sales@datapaq.com  
Web: www.datapaq.com

**Corrispondente Italiano**  
Linea Diretta: Cell. +39 335 284 029  
Numero Fax: +44 1223 423 306  
e-mail: vendite@datapaq.co.uk  
Web: www.datapaq.it



[www.datapaq.it](http://www.datapaq.it)

A causa dei continui miglioramenti apportati ai prodotti, le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.  
wave-Q18.qxp - Iss 01 - DEC06